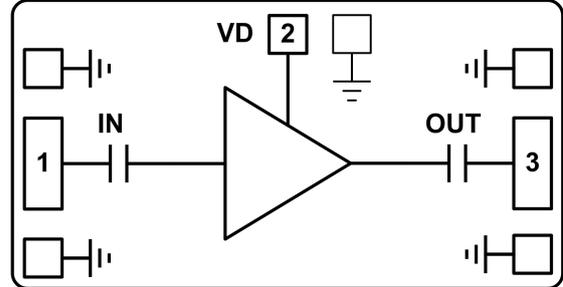




主要特点

- 工作频率: 24 - 40 GHz
- 噪声系数: 2.0 dB
- 增益: 21 dB 4dB 正斜率
- P1dB: +3.5 dBm
- 自偏置供电: +5 V @ 13mA
- 输入/输出: 50 Ohm 匹配
- 芯片尺寸: 1.5 × 0.8 × 0.1 mm³

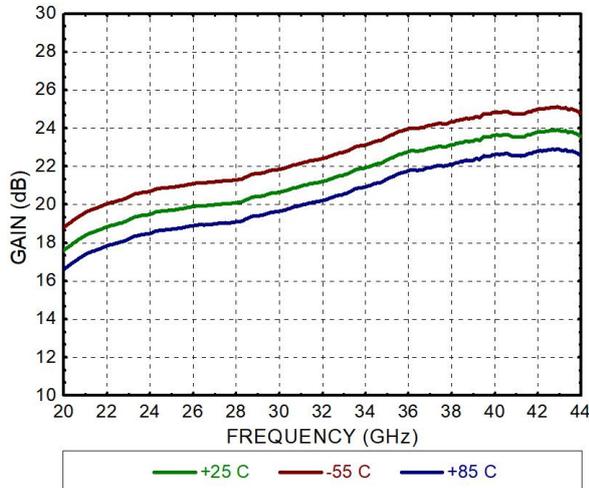
功能框图



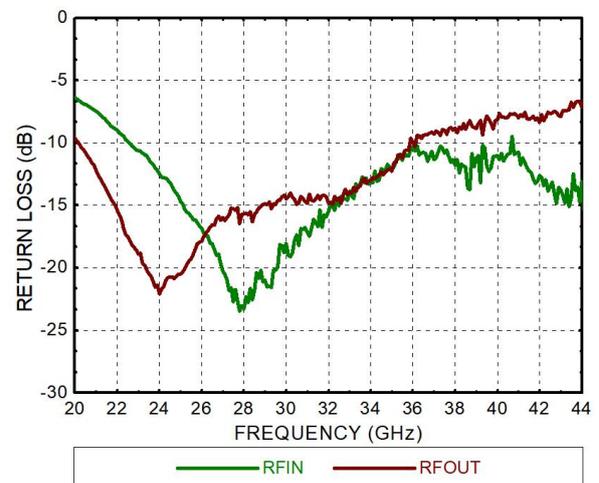
性能指标 ($T_A = +25^\circ\text{C}$, $V_{DD} = +5\text{ V}$, $I_{DD} = 13\text{ mA}$)

参数	最小	典型	最大	单位
频率范围	24-40			GHz
增益		21		dB
增益平坦度		±2		dB
输入回波损耗		10		dB
输出回波损耗		10		dB
输出功率 1dB 压缩点		3.5		dBm
饱和功率		4.5		dBm
输出 IP3		14		dBm
噪声系数		2.0		dB
工作电流	8	13	18	mA

增益

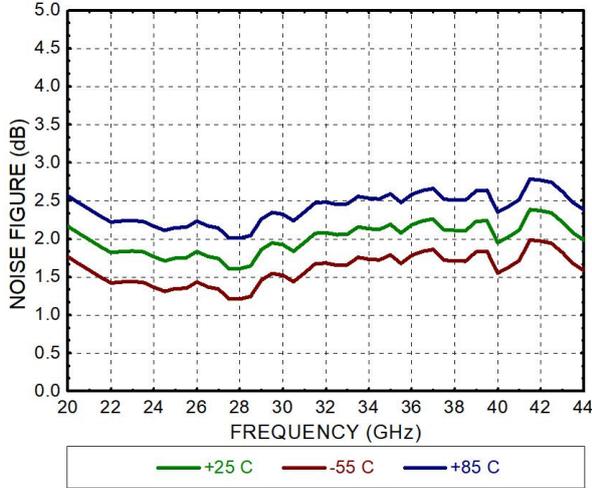


回波损耗

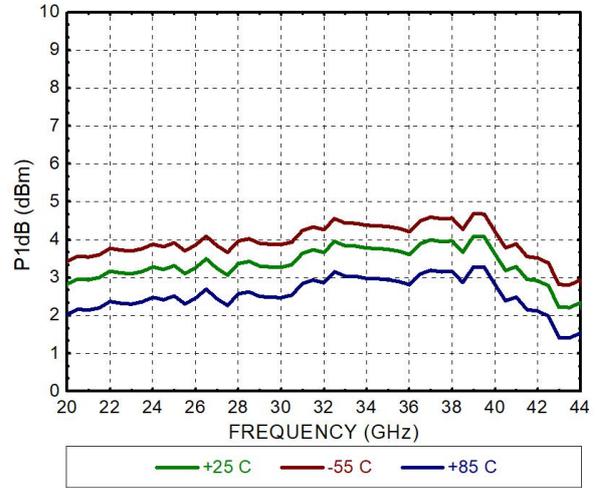




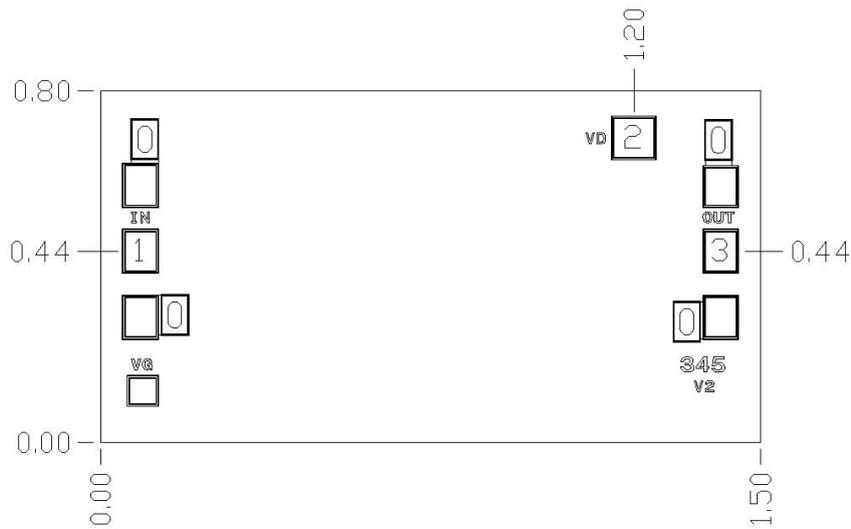
噪声系数



输出功率 P_{1}



物理参数

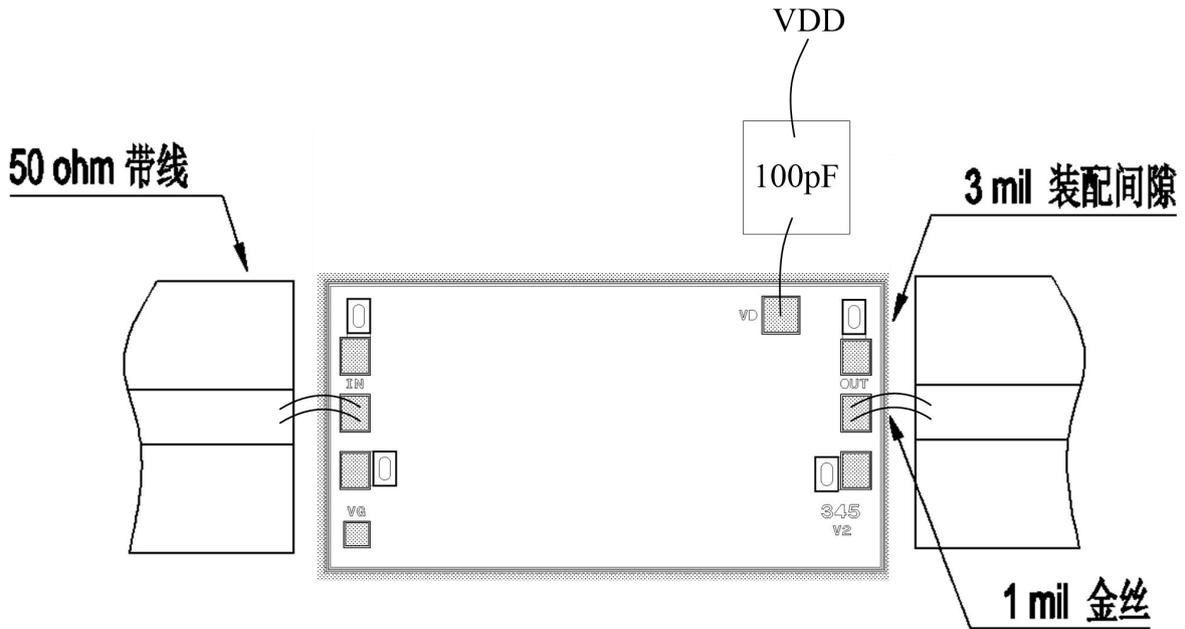


焊盘描述

焊盘序号	功能	描述
1	IN	该焊盘是 AC 耦合, 并匹配至 50 Ohm
2	VD	该焊盘提供放大器的电源电压, 需要外接 100pF 旁路电容
3	OUT	该焊盘是 AC 耦合, 并匹配至 50 Ohm
芯片背面	GND	芯片背面必须连接至 RF/DC 地



装配图



注意事项

1. 芯片厚度为 100 μm
2. 典型键合焊盘尺寸为 $100 \times 80 \mu\text{m}^2$
3. 键合焊盘金属化: 金
4. 芯片背面镀金
5. 芯片背面接地
6. 未标注的键合焊盘不需要连接

极限参数

1. 电源电压: +6 V
2. 射频输入功率: +18 dBm
3. 储存温度: $-65 \sim +150 \text{ }^\circ\text{C}$
4. 工作温度: $-55 \sim +85 \text{ }^\circ\text{C}$